

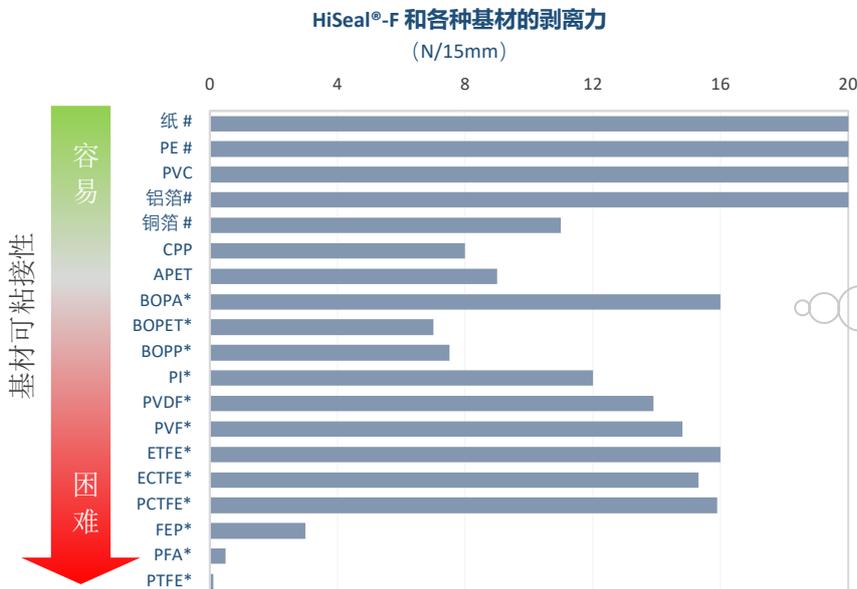
HiSeal®-F 热粘接膜

还在为**粘接烦恼**? HiSeal®-F **热粘接膜**专为解决包装和电子封装中的粘接难题而开发, 可以将难以粘接的PP、PET、PI、**特氟龙**(ETFE、FEP)、PCTFE、PVDF等氟膜, 以及铝箔、铜箔等各种材料, 通过热封粘接起来。

HiSeal®-F 优点:

1. 能高效粘接各种难以难以粘接的材料, 如 **PP、PET、PI** 以及 **ETFE、FEP、PVDF** 等各种**氟膜**。
2. 使用简单环保的热贴或高周波焊接工艺, 无溶剂污染烦恼。
3. 反应性粘接力强, 可靠性高, 柔韧性好适合弯曲折叠。
4. 宽热封窗口, 适合各种材料操作温度。

HiSeal®-F 热封测试:



重要: 请根据你的应用和基材材质, 咨询 Visualplas 技术支持, 获得 HiSeal®-F 薄膜选择、基材处理和加工指导。

测试方法: 贴合以上各种基材/HiSeal®-F/铝箔或 PVC, HiSeal®-F 薄膜为 25um 或 50um, 热压温度视基材厚度和材质, 在 100°C 到 230°C; 压力 0.5Mpa. 样品室温放置 24 小时后测试剥离力。

备注: # 表示粘接力过强, 材料发生内在性撕裂破坏, 数据为估计值。

Note: * 表示基材表面预先做电晕处理。

HiSeal®-F 薄膜基本参数:

性质	典型值	单位	测试方法
厚度	25, 50	微米	千分尺
外观	无色透明	-	目测
硬度	64	Shore A	ASTM D2240
伸长率	1000	%	ASTM D638
弯曲模量	<28	MPa	ASTM D638



HiSeal®-F 热粘接膜储存

HiSeal®-F 具有热反应活性, 建议低温干燥的密封储存, 储存温度不超过 48°C。